

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2020-100

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于公司向银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请综合授信额度的情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月18日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，同意根据公司业务发展及资金情况，向兴业银行东莞分行申请不超过人民币9,000万元的授信额度，用于补充流动资金。具体情况如下：

银行名称	申请授信额度	担保类型	期限	融资方式
兴业银行东莞分行	9,000万元	抵押	一年	综合授信

截至目前，公司已累计获得银行等各类金融机构及融资租赁机构（不含安徽正奇融资租赁有限公司及其一致行动人）综合授信额度1.5亿元。本次向兴业银行申请9000万元授信额度后，累计综合授信额度将超过给予董事长赵积清先生的授权（不超过2亿元），但仍在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。

二、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2020年9月18日